(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005 年1 月27 日 (27.01.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/007748 A1

(51) 国際特許分類": C08L 83/16, C01B 33/12, H01L 21/312, C09D 183/16, H01L 21/768

[CH/CH]; 4132 ムッテンツ1、ロートハウスシュト

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/009649

(22) 国際出願日:

2004年7月7日 (07.07.2004)

(25) 国際出願の倉語:

日本暦

(26) 国際公開の官語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-199363 2003年7月18日(18.07.2003) JP

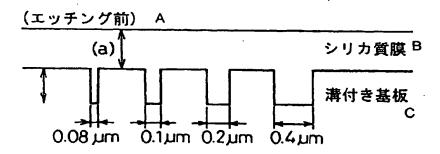
(71) 出願人(ポツワナ, 日本, ナミピア, 米国を除く全ての 指定国について): クラリアント インターナショナ ルリミテッド (CLARIANT INTERNATIONAL LTD.) ラーゼ 6 1 Muttenz (CH).
(71) 出願人 (日本についてのみ): クラリアント ジャパン株

- (71) 出願人 (日本についてのみ): クラリアント ジャパン株 式会社 (CLARIANT (JAPAN) K.K.) [JP/JP]; 〒1138662 東京都文京区本駒込二丁目 2 8 番 8 号 文京グリー ンコート センターオフィス 9 階 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 脊木 倫子 (AOKI, Tomoko) [JP/JP]; 〒4371496 静岡県小笠郡大東町千浜3810 クラリアントジャパン株式会社内 Shizuoka (JP). 骨木 宏幸 (AOKI, Hiroyuki) [JP/JP]; 〒1138662 東京都文京区本駒込 2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス 9 階 クラリアントジャパン株式会社内 Tokyo (JP).

[镜葉有]

(54) Title: PHOSPHORUS-CONTAINING SILAZANE COMPOSITION, PHOSPHORUS-CONTAINING SILICEOUS FILM, PHOSPHORUS-CONTAINING SILICEOUS FILM, METHOD FOR PRODUCING PHOSPHORUS-CONTAINING SILICEOUS FILM, AND SEMICONDUCTOR DEVICE

(54) 発明の名称: リン含有シラザン組成物、リン含有シリカ質膜、リン含有シリカ質充填材、リン含有シリカ質膜 の製造方法及び半導体装置



A...(BEFORE ETCHING)

B...SILICEOUS FILM

C...GROOVED SUBSTRATE

(57) Abstract: Disclosed is a phosphorus-containing siliceous material having a relative dielectric constant of 3.5 or less. Also disclosed is a phosphorus-containing silazane composition which is characterized by containing a polyalkyl silazane and at least one phosphorus compound in an organic solvent. The composition is applied to a substrate to form a film, and the thus-formed film is preliminarily fired at 50-300°C and then fired at 300-700°C in an inert atmosphere, thereby forming a phosphorus-containing siliceous film. The phosphorus compound is preferably a pentavalent phosphate ester or a phosphazene compound.

▼ (57) 要約: 本発明は、比誘電率3. 5以下のリン含有シリカ質材料を提供することを目的とする。本発明による
○ リン含有シラザン組成物は、有機溶媒中にポリアルキルシラザン及び少なくとも1種のリン化合物を含むことを特 敬とするものである。該組成物を基板上に整布して得られた膜を、温度50~300℃で予備焼成し、次いで温度 300~700℃の不活性雰囲気中で焼成することにより、リン含有シリカ質膜が得られる。本発明によるリン化 ○ 合物は、5価のリン酸エステル又はホスファゼン化合物であることが好適

/観葉有/

O 2005/007748 A1